

Prensa Térmica Automática Industrial 100 Toneladas 350°C 600X600Mm De Piso

Número do item: XP93



introdução

Prensa térmica automática industrial com capacidade de 100 toneladas, placas de 600x600mm, temperatura máxima de 350°C e controle PID programável para processamento térmico preciso. Ideal para moldagem de compósitos, vulcanização de borracha e laminação. Solicite um orçamento.

[Saiba mais](#)

Aplicação	Descrição	Benefício Principal
Vulcanização de Borracha	Moldagem e cura de peças de borracha, como vedantes, juntas e amortecedores.	Pressão uniforme e rampas de temperatura precisas garantem reticulação consistente e mínimo refugo.
Moldagem de Compósito de Fibra de Carbono	Cura de pilhas de pré-impregnados sob calor e pressão controlados para produzir painéis estruturais leves para aeroespacial e automobilismo.	Perfis de rampa programáveis otimizam a impregnação das fibras e a redução de vazios, maximizando as propriedades mecânicas.
Laminação de Compósito de Fibra de Vidro	Fabricação de componentes duráveis de fibra de vidro, como cascos de barcos e pás de turbinas eólicas.	O tamanho grande da placa e a alta força permitem a moldagem de peças grandes em uma única etapa, reduzindo etapas de montagem.
Produção de Laminado de Alta Pressão (HPL)	Colagem de laminados decorativos a substratos para móveis, pisos e painéis arquitetônicos.	A distribuição uniforme de pressão e a temperatura estável previnem a delaminação e defeitos de superfície.
Compressão de Eletrodo de Bateria	Pressagem a quente de materiais de eletrodo para melhorar a densidade e condutividade em pesquisa de baterias.	O controle fino da pressão e o aquecimento uniforme garantem espessura e desempenho consistentes do eletrodo.
Consolidação de Chapas Termoplásticas	Pressagem de múltiplas camadas de filmes termoplásticos em chapas espessas para estoque de usinagem.	A programação de pressão multiestágio previne empenamento e garante fusão homogênea do material.
Compactação e Sinterização de Pó	Pressagem a quente de pós metálicos ou cerâmicos em pré-formas densas para materiais avançados.	A alta força e capacidade de temperatura alcançam densidade quase teórica em um processo de etapa única.
Laminação de Placa de Circuito Impresso	Colagem de camadas de cobre e pré-impregnado sob temperatura e pressão controladas para fabricação de eletrônicos.	O alinhamento preciso e a pressão de colagem consistente garantem integridade e confiabilidade do sinal.

Parâmetro	Especificação	Observações
Modelo	XP93	
Pressão Máxima	100 Toneladas (1000 KN)	Sistema hidráulico pesado
Controle de Pressão	Controle programável com rampa	Pressão multiestágio
Temperatura de Trabalho	0 - 350 °C	Controle de aquecimento independente de zona dupla
Controle de Aquecimento	Controle independente de placa dupla, controle de temperatura programável com rampa	
Tamanho da Placa	600 × 600 mm	Adequado para chapas grandes ou múltiplos moldes
Abertura / Luz do Dia	250 mm	Abertura ampla para fácil carregamento do molde
Método de Resfriamento	Resfriamento por água circulante	Resfriador dedicado recomendado (opcional, 1600 USD)
Fonte de Alimentação	Trifásico 380V-415V, 50/60 Hz selecionável	Personalizável por país de destino
Dimensões (C × L × A)	980 × 890 × 1750 mm	Design de piso

Parâmetro	Especificação	Observações
Peso Líquido	1200 kg	Estrutura pesada de 1,2 tonelada